



boschman
advanced packaging technology

公司文件夹



Boschman 是提供高度创新封装解决方案的一站式服务提供商。

Boschman 是一家以解决方案为导向的荷兰高科技公司，专注于提供先进的封装解决方案。我们秉持独特的一站式服务理念，从构想到工业化，针对所有封装业务为客户提供一站式接洽点。这种方式可确保所有工艺得到仔细监控和集成，从而创造最有效且高效的封装解决方案，帮助客户尽可能缩短产品上市时间。

我们的技术

- **银烧结**

银烧结是一种经过验证的芯片粘接技术，可确保无空隙和高强度键合，并具有高导热性和导电性。这种技术良品率高，十分可靠。

- **薄膜辅助塑封 (FAM)**

薄膜辅助塑封包括一系列涉及在模具与待封装的产品之间使用薄膜的独特技术。该技术具有诸多优势。

- **动态压头技术**

动态压头技术 (DIT) 是一项专利技术，旨在进一步优化 FAM 的性能，以在一个或多个表面上实现自动和动态压力控制。该技术还可让特定区域充分暴露。

- **树脂通孔 (TPV)**

树脂通孔 (TPV) 是一项专利技术，可通过（传递模塑）封装创建高密度、高纵横比的电气和/或光学互连。

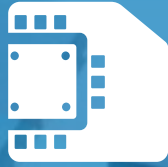
我们的应用领域

- 微机电系统和传感器
- 高功率模块和封装
- 光学封装
- 2.5D/3D 封装
- 智能卡

我们的行业应用重点

我们正在为以下行业的客户提供优质服务：

- 汽车
- 医疗
- 航空航天
- 移动
- 工业 & 可再生能源



package development by boschman



封装概念

在概念阶段，我们通过模流分析、应力和热有限元 (FEM) 仿真来研究关键设计点。



封装设计

定义细节，并在装配风险和使用的技术与成本方面权衡利弊。

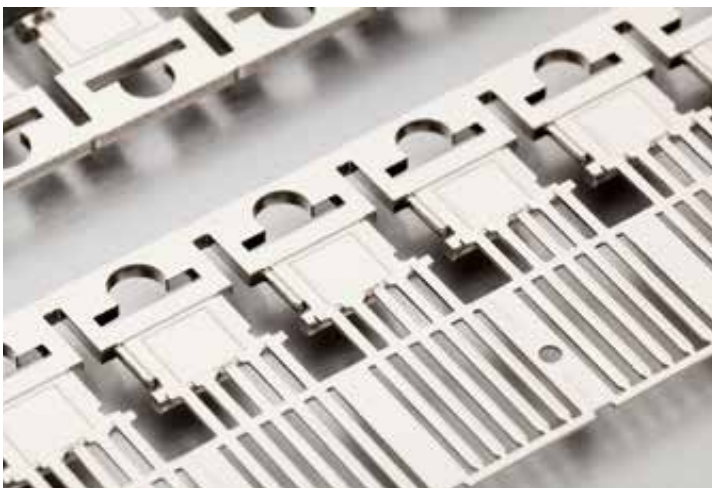


原型制作和打样

原型制作的目的是证明概念的工作原理并根据规格提供封装产品。原型制作适用于可靠性测试和客户打样。

从概念化到高良品率生产。

我们研究、设计先进的封装概念并制作原型。我们可以与您合作开发和装配创新的即用型封装解决方案。我们需要首先了解彼此的期望、能力和限制，然后才能协助您快速构建未来的产品！



我们可为高增值产品提供具有增强功能的封装解决方案。从逐步改进的标准封装 (QFN、TO、LGA、SO / SIL / DIL 等) 到完全定制的封装，我们可以根据您的应用要求定制封装设计，确保满足您的性能和可靠性规范。我们在符合生产要求的设备上制造开发原型，以便您将这些原型用于功能测试、可靠性测试和客户打样。我们的封装开发活动完全符合 ISO-9001-2015 标准。



**assembly
services**
by boschman



中小批量生产装配

我们能够每月生产数十万件合格产品，具体取决于封装要求。



向大批量生产转移 (OSAT 或非专属)

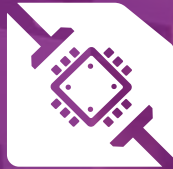
当订单量超过我们的中小批量产能时，我们可以协助客户将订单向内部（非专属）生产或大批量 OSAT 转移

从样品平稳过渡到大批量装配

我们提供使用半自动或全自动工艺生产中小批量产品的服务。在“从构想到生产”的周期中，我们可以单独提供装配服务，也可以结合提供其他服务。



内部开发的封装解决方案可以相对快速地转移到小批量或中批量生产。我们的装配服务特别适合无晶圆厂设计公司、创业公司和提供高增值航天 / 航空电子或复杂产品的公司。我们拥有 250 平方米的洁净室设施，应用范围为 ISO-6（用于芯片粘接和打线接合等工艺）到 ISO-8（用于塑封和烧结）。我们可以根据客户要求将生产转移到非专属生产或 OSAT。我们的装配服务完全符合 Rohs、REACH 和 ISO-9001-2015 标准。



equipment
by boschman



银烧结

银烧结是一种芯片粘接技术，可确保无空隙和高强度键合，并具有高导热性和导电性。因此良品率高，十分可靠。



薄膜辅助塑封 (FAM)

薄膜辅助塑封包括一系列涉及在模具与待封装的产品之间使用薄膜的独特技术。该技术具有诸多优势。



卷对卷

通过卷对卷塑封提供最高生产率，这在很大程度上取决于有效模具长度和加工时间，从而制造出成本最低的塑封制品。

我们的技术造就创新解决方案

Boschman 专注于为全球电子装配行业开发和供应先进的传递模塑封和烧结系统。我们可为各种产品提供增值封装和键合工艺及设备解决方案。



30 年多年来，我们始终专注于为全球电子装配行业开发和供应先进的传递模塑封技术，最近我们还推出了烧结系统。我们可为各种产品提供增值封装工艺及设备解决方案。我们的塑封系统装机量非常大，在银烧结解决方案方面，自 2014 年起就一直保持市场领先地位。我们还定期与客户的研发部门合作，共同开发和研究创新的封装生产概念。尽早参与开发过程是获得最高质量、可靠工艺、最低运营成本和最短上市时间的先决条件。

“尺寸更小、性能更好、成本更低，
为您的产品提供最好的封装！”



package
development



assembly
services



equipment

Boschman | 先进封装技术

Stenograaf 3 6921 EX Duiven 电话 +31 26 319 4900 电子邮箱 info@boschman.nl

www.boschman.nl